

Tecnologia	Equipamento	Função
LITOGRAFIA	Fotoalinhadora EVG620	Alinhamento de máscaras para fotolitografia de dupla face com precisão de até 0.5 $\mu\text{m}$
	Spinner, Hot Plate e Revelador BREWER Cee	Deposição, recozimento e revelação semiautomática de fotoresistes
	Mask Writer Heidelberg $\mu\text{PG}$ 501	Litografia por escrita direta com resolução de até 1 $\mu\text{m}$ e opção de escala de cinza
DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS	Sistema PVD KJLC LAB 18	Deposição de filmes finos por sputtering e evaporação térmica
	PECVD Oxford Instruments Plamalab 80	Deposição assistida por plasma de $\text{SiO}_2$ , $\text{SiN}_x$ e $\text{SiO}_x\text{N}_y$
	Parylene Coater SCS LABCOATER 2	Deposição de Parylene
DEPOSIÇÃO DE FILMES ESPESSOS	Serigráfica AUREL VS1520M	Deposição de filmes espessos por serigrafia
CORROSÃO SECA	DRIE-ICP Oxford Instruments Plamalab 100	Corrosão seca anisotrópica assistida por plasma (com opção do processo Bosch) de Si, $\text{SiO}_x$ e $\text{SiN}_x$
	Plasma Cleaner Diener NANO	Limpeza e ativação assistida por plasma de superfícies
PROCESSOS ÚMIDOS	Bancada para processo de limpeza	Estação dedicada para limpeza de lâminas
	Bancada para corrosão úmida	Estação dedicada para processos de corrosão úmida
	Sistema HF Vapor	Corrosão por vapor de HF
MICROSCOPIA E METROLOGIA	MEV ZEISS EVO MA10	Microscopia eletrônica de varredura
	EDS Bruker QUANTAX 200	Espectroscopia de raios X por dispersão em energia para análise de materiais
	Perfilômetro Bruker DektakXT	Perfilometria de contato com resolução de até 1 $\text{\AA}$
PROCESSAMENTO DE WAFERS	Wafer Bonder AML-AWB	Colagem de lâminas tipo anódica, eutética, polimérica, frita de vidro ou termocompressão
	CMP Logitech CM61 Orbis	Polimento e planarização de lâminas
	Wafer Dicing ADT 7100	Corte automatizado de substratos de silício, vidro e cerâmica